



Orbotech Nuvogo™ 780/780XL

量産向けダイレクトイメージング装置 (DI)



Orbotech Nuvogo 780/780XL

Orbotech Nuvogo 780/780XLは、高多層基板、HDI基板向けの量産用ダイレクトイメージング装置です。製造現場で実証されているLarge Scan Optics™ (LSO) テクノロジーとMultiWave Laser™ (マルチ・ウェーブ・レーザー) テクノロジーにより、様々なレジストに対して高品質な露光が可能であり、トータルコスト(TCO)の削減を実現します。



特長

量産向けデジタルイメージング

- ハイパワーレーザー使用による高いスループット
- 革新的な2段テーブル搬送メカニズムにより装置稼働時間を最大限に活用
- インラインをはじめとする様々なオートメーションに対応
- クリーンな作業環境

MultiWave Laserテクノロジーによる幅広いレジストへの対応

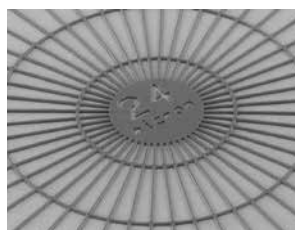
- 様々なレジストに高い生産性で対応
- MultiWave Laserテクノロジーによる高品質パターン形成

LSOテクノロジーによるすぐれた露光品質

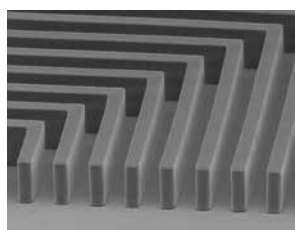
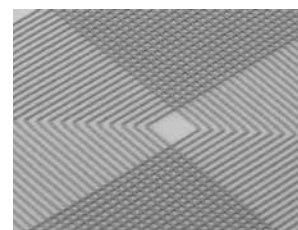
- 深い焦点深度により、歪んだ基板でも均一なパターンを形成
- 独自の光学設計による最適な露光
- ±12μmの高精度な位置合わせ

製造コストの大幅削減

- 高い露光稼働率により、長期的に明確なコストが削減できます
- 様々なレジストの種類に対応することにより、コストの点からの材料選択も可能となります



最小24μmまでのファインパターンに対応



MultiWave Laserテクノロジーによるダブルラミネーションレジストへの露光



テクノロジー



LSO™ Technology



MultiWave Laser™ Technology

量産向けデジタルイメージング装置

MultiWave LaserテクノロジーによるOrbotech Nuvogo 780/780XLは、最先端の光学系を搭載しファインパターンを高スピードで露光することができます。2段テーブル搬送メカニズムは、搬送における露光時間のロスを削減し、稼働時間を最大限活用することができます。また、すばやいセットアップが可能のため、ジョブ切替を効率的に行い、装置稼働時間を最大限に活用します。Orbotech Nuvogo 780/780XLはクリーンな環境で全自動化で作業を行うため、高品質な生産を行うことができます。

MultiWave Laserによる幅広いレジストへの対応

MultiWave Laserを搭載したOrbotech Nuvogo 780/780XLは様々なレジスト素材に対応し、最大限のフレキシビリティを提供いたします。また、歪んだ基板にも高い均一性で露光が可能です。

LSOテクノロジーによるすぐれた露光品質

すでに製造現場で実証済みのLSOテクノロジーとの併用により、深い焦点深度を保ちながら、厚さや素材の違う製品（フレックス、リジッドフレックス基板）にも対応することが可能です。

様々なスケーリングモード

- オートスケーリング、固定スケーリング、グループスケーリング、ワイズスケーリング

トレーサビリティ対応

- 基板に英数字、1次元バーコード、2次元バーコード（データマトリクスコード）で、シリアルナンバー、日付スタンプ、マシンID情報を露光することで、トラッキングや不具合品などフィードバックが可能

高精度なレジストレーション

- ±12µmの精度

簡単操作

- 高速&簡単セットアップを可能にする直感的かつユーザーフレンドリーなインターフェイス
- CAMとのシームレスな接続による高速、簡単セットアップが可能
- あらゆる生産仕様に応じて、多様なアライメントマークに対応

製造コストの大幅削減

Orbotech Nuvogo™ Diシリーズは、高難易度化していく量産製造過程において、コスト削減を提供いたします。その高い生産性で基板1枚あたりの露光コストを削減し、低コストでの最大限の製造利益をご提供することができます。製造にかかるコストなどを削減することができます。また、様々なレジストタイプに対応することにより、コスト視点でのレジスト露光をご提案することができ、更なるコスト削減を提供することができます。

仕様

	Orbotech Nuvogo 780	Orbotech Nuvogo 780XL
最大スループット*	300 (面 / 時) 基板サイズ: 609.6x457mm	290 (面 / 時) 基板サイズ: 635x457mm
最小パターンサイズ	24μm	
解像度	2.0μm	
位置合わせ精度 (FtG) **	±12μm	
表裏位置合わせ精度 (FtB) **	24μm	
最大基板サイズ	635mm x 660mm	660mm x 812mm
最大露光サイズ	609.6mm x 660mm	635mm x 812mm
基板厚	0.025mm - 8mm	
設定露光エネルギー範囲	25 - 2,200 mJ/cm ²	

*フォトレジストの特性により異なります

** 3σ、フルフォーマット、4点アライメント

仕様は予告なく変更することがあります

KLA SERVICES

装置の設置やシステムの最適化から生産性の向上、グローバルなサプライチェーンマネジメントまで、KLAは、世界中のお客様から信頼されるパートナーとして、装置の性能と稼働率を最大限に高めることに焦点を当てたサービスを提供しています。

© 2023 KLA Corporation. KLAは全世界において著作権に関する権利を有します。当社は、ハードウェアおよび/またはソフトウェアの仕様を予告なく変更する権利を有します。記載されたブランド名および製品またはサービス名は、KLA、Orbotechに限らず、全て商標権者の登録商標である可能性があります。

KLA Corporation
TEL: 045-522-7725
Email: Japan-ICS-PCB@kla.com
www.kla.com

Rev_8.1_08-31-2023 (J)